

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-031

鸿利智汇集团股份有限公司

关于与交易对方签署《协议书》的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次事项的基本情况

2015年4月，公司与自然人李少飞签署了《关于深圳市旭晟实业有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司向深圳市旭晟实业有限公司（以下简称“旭晟半导体”）增资787.20万元，持有其19.68%股权。此后，公司分别于2016年5月、2017年5月及2017年10月向旭晟半导体投资，累计投资总额为2,136.59万元，合计持有旭晟半导体28.19%股权。

2019年12月，公司与李少飞签署了《关于深圳市旭晟半导体股份有限公司业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），李少飞需向公司支付2,433万元股权转让款。

2024年4月，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于与交易对方签署<协议书>的议案》，上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。公司已收到李少飞支付的第一期股权转让款1,000万元。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、本次事项的进展情况

根据《协议书》约定，李少飞将其持有的旭晟半导体17.59%股权质押给公司（旭晟半导体注册资本为人民币4,238.6429万元，本次质押股权数额为人民币745.5787万元，占旭晟半导体17.59%股权）。

上述股权质押手续已于2024年7月4日办理完毕。

三、对公司的影响

《协议书》约定待收回的股权转让款存在不确定性风险，公司将按照《协议书》约定时间督促交易对方及时履行义务，切实维护全体投资者的合法权益。

公司将持续关注本事项进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年7月4日